

第 16 回 有機/無機接合研究委員会

日時 : 2023 年 3 月 15 日 (水) 13:00~16:00
場所 : 慶應義塾大学 矢上キャンパス (神奈川県横浜市)

プログラム

司会 朝桐 智 ((株) 東芝)

13:00~13:10 委員会議事

13:10~13:50

『簡便性と接着機能を両立するフィルム型接着剤 WelQuick の特徴と機能』(40 分)

..... ○高橋 信行 ((株)レゾナック)

13:50~14:30

『塩害環境での樹脂材料のインピーダンスの変化』(40 分)

.....○堀江 俊男 ((株)豊田中央研究所)

14:30~14:40 休憩

司会 井上 雅博 (群馬大学)

14:40~15:20

『抵抗溶接技術を応用した金属と樹脂の接合装置』(40 分)

..... ○佐伯 修平 (電元社トーア(株))

15:20~16:00

『レーザを用いた熱可塑性樹脂と金属との接合法の開発』(40 分)

..... ○宮内 貴章、玉城 怜士、長谷川 慎一、上山 智之 ((株)ダイヘン)

() 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会